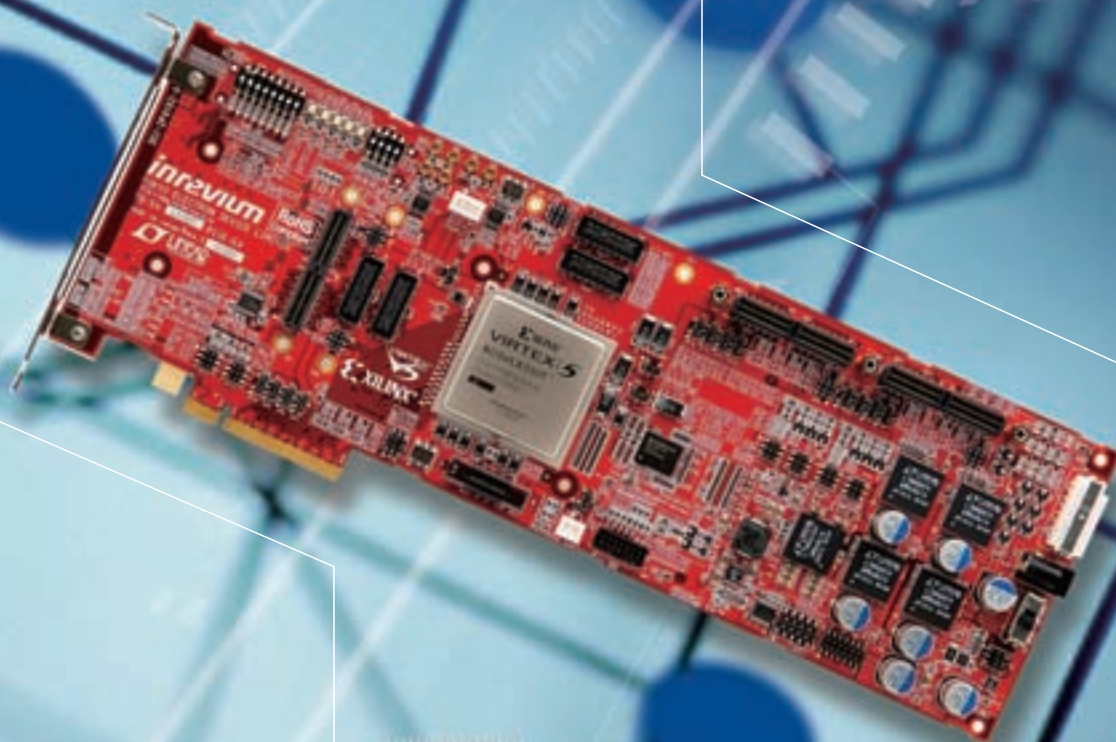


投資家の皆様へ

INVESTORS GUIDE 2009

東京エレクトロン デバイス
インベスターズガイド2009

証券コード 2760



東京エレクトロン デバイス

contents

トップメッセージ	01
経営戦略及び対処すべき課題など	02
事業紹介	03
半導体及び電子デバイス事業	04
コンピュータシステム関連事業	07
開発ビジネス	09
マーケット情報	10
業績レビューと次期の見通し	11
財務諸表	12
財務データ	15
会社概要・株式情報	18

profile

1965年	東京エレクトロン(株)で、電子部品の販売(フェアチャイルド社など)を開始
1990年 9月	東京エレクトロン デバイス(株)で電子部品の販売を開始
1998年 7月	東京エレクトロン(株)から電子部品に関する営業をすべて譲り受け、販売を開始
2003年 3月	東京証券取引所市場第二部に上場
2004年 1月	中国・上海に子会社の上海華桑電子有限公司(通称:東京エレクトロンデバイス上海)を設立
2005年 1月	中国・香港に子会社の香港華桑電子有限公司(通称:東京エレクトロンデバイス香港)を設立
2006年 10月	東京エレクトロン(株)から、コンピュータ・ネットワーク事業を承継し、販売を開始
2008年 1月	シンガポールに子会社のTokyo Electron Device Singapore Pte. Ltd.(通称:東京エレクトロンデバイスシンガポール)を設立
2008年 2月	国内販売子会社としてパネトロン株式会社を設立

将来の業績見通し等に関する注意事項

このインバスターズガイドは、2009年7月1日時点で作成されています。ビジネス戦略、業績予想等の将来の見通しに関する事項は、その時点で入手可能な情報から当社の経営者の判断に基づいて書かれており、経営環境の変化により修正することがあります。したがって、当社は、内容の正確性、信頼性等、一切保証しませんので御了承下さい。最新情報については、公表資料または当社Webサイトを御参照下さい。



代表取締役社長
砂川 俊昭

2009年3月期の活動方針として、

半導体及び電子デバイス事業においては、

- ①産業機器分野のお客様開拓
- ②アジア地域への販売強化
- ③自社ブランド(インレビウム)商品の新規商品開発の加速化

コンピュータシステム関連事業においては、

- ①システム構築ビジネスの推進
- ②情報セキュリティ分野のソフトウェアの拡販

にそれぞれ取り組んでまいりました。

しかしながら、世界的な景気悪化がエレクトロニクス業界、IT業界にも波及し、特に11月以降急激に需要が冷え込む状況となり、当社の事業環境も非常に厳しいものとなりました。

2009年3月期の連結業績は、売上高947億1百万円(前期比15.5%減)、経常利益20億4千1百万円(同47.0%減)、当期純利益は、特別損失として貸倒引当金繰入額や本社移転費用などを計上したため6億1千7百万円(同71.8%減)となりました。なお、1株当たり配当金は、当初の予定通り年間6,600円とさせていただきます。

2010年3月期の半導体市場は、下期にかけて緩やかに回復すると想定しておりますが、本格的な回復には至らず、IT市場もマイナス成長を想定しております。

これらを踏まえ、連結業績見通しを売上高780億円(前期比17.6%減)、経常利益13億円(同36.3%減)、当期純利益6億2千万円(同0.4%増)といたしました。1株当たり配当金は、年間5,000円を予定しております。

厳しい事業環境下ではありますが、役員および社員が一丸となり、業績向上、企業価値増大に向け精進してまいりますので、今後とも、変わらぬご支援のほどよろしくお願い申し上げます。

経営戦略及び対処すべき課題

① 利益確保に向けた体質強化

- 2010年3月期におきましては、景気の急速な回復には至らないという見通しを踏まえ、全社的な管理可能費用の大幅な削減に努めてまいります。
- 効率的な営業展開を目指し、かつ、将来の成長を見据えた組織改革を行ってまいります。

② 将来の成長を見据えた成長戦略

- 半導体及び電子デバイス事業につきましては、事業再編や提携等の動きにあわせて商権拡大を図るとともに、新規顧客・新規商品の開拓を推進し、事業の一層の強化に努めてまいります。また、従来の産業機器向けビジネスに加え、今後の成長が見込まれる分野（環境・セキュリティ等）への販売活動にも注力してまいります。

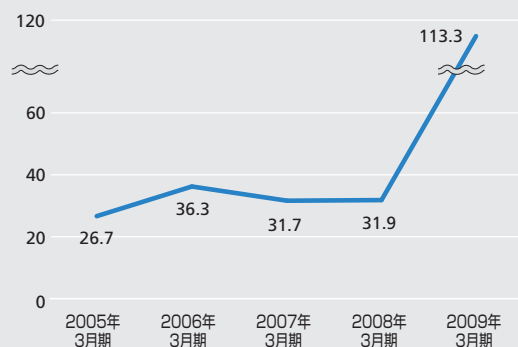
- 海外事業につきましては、ASEAN地域における顧客サポート体制を充実するとともに、付加価値の高い自社商品のグローバルな販売展開を図ってまいります。
- コンピュータシステム関連事業につきましては、事業の業績拡大を図るべく、個々の製品販売中心の営業体制から顧客別営業体制に組織を再構築し、より一層顧客に密着した営業展開の推進に努めてまいります。
- 開発ビジネスにつきましては、自社ブランドである「inrevium（インレビウム）」の商品開発に引き続き注力するとともに、設計から製造・品質保証までの一貫したものづくり体制を確立し、OEMビジネスの強化に努めてまいります。

配当方針

2009年3月期におきましては、当社を取り巻く事業環境が非常に厳しいものとなりましたが、継続的かつ安定的な配当実施という基本方針を勘案し、中間配当3,300円、期末配当3,300円、合わせた年間配当を1株につき6,600円とさせていただきます。なお、2010年3月期の配当予想につきましては、1株当たり年間配当5,000円（中間2,500円・期末2,500円）を予定しております。

	2009年3月期		2010年3月期（予定）	
	中間	期末	中間	期末
1株当たり配当金(円)	3,300	3,300	2,500	2,500
配当性向	113.3%		85.5%	

配当性向(%)



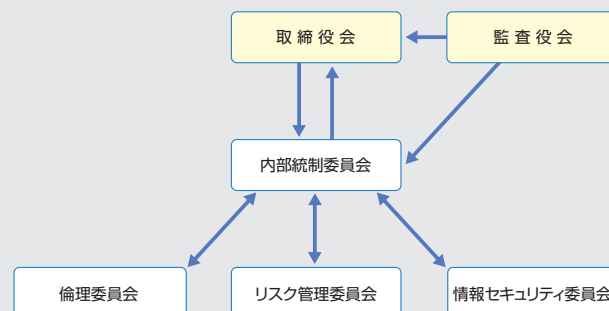
コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが求められる中、株主各位およびステークホルダーに対し一層の経営の透明性を高めるため、公正な経営を実現することを最優先に考えております。当社の内部統制システムは、内部統制システム全体の整備と運用を推進する内部統制委員会のもと、倫理委員会がコンプライアンス体制を、リスク管理委員会がリスク管理体制を、情報セキュリティ委員会が情報の保存および管理体制を推進しております。

なお、監査役会は、取締役会に対し、内部統制に関する提言を行い、内部統制委員会の監視も行っております。

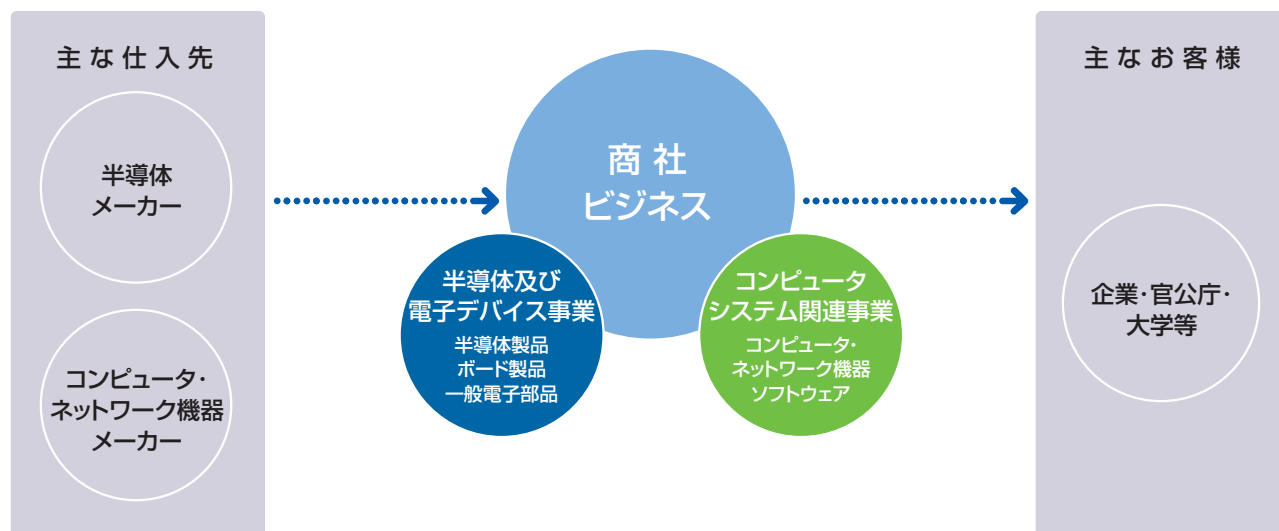
今後も経営の公正さと透明性の向上に努めてまいります。

内部統制システム



事業紹介

当社グループは、集積回路（IC）を中心とした半導体製品、ボード製品、一般電子部品やコンピュータ・ネットワーク機器、ソフトウェア等を国内外のメーカーから仕入、主に国内の電子機器メーカーに販売する専門商社です。



セグメント情報

半導体及び電子デバイス事業

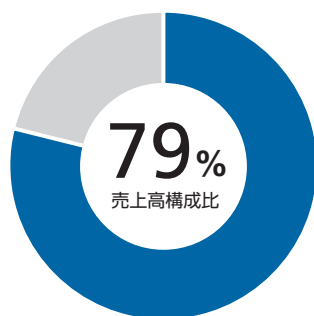
2009年3月期

売上高

749億円

営業利益

7億3千6百万円



コンピュータシステム関連事業

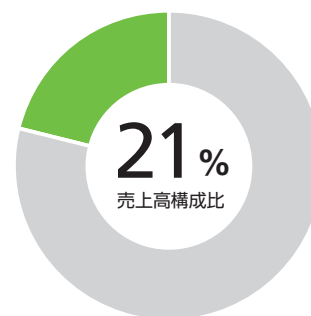
2009年3月期

売上高

197億円

営業利益

11億3百万円

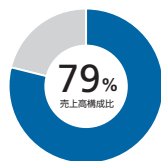


注力する開発ビジネス（自社ブランドビジネス）

当社の持つ技術力を付加価値としてお客様にご提供するビジネスです。お客様の要求に基づき、半導体製品、ボード製品の設計を請け負っています。また、市場ニーズに沿った半導体の企画開発を行い、自社ブランド商品として製品化しています。（詳細は9ページをご参照下さい）

inrevium

InreviumはIntellectual (知的な)、Revolutionary (革新的な)、ium (要素) などの単語の一部を組み合わせた造語です。当社が持つ情報・技術・サービスなどの商品化を通じて、お客様の抱える課題を解決し、事業活動に貢献していきたいとの強い意味が込められています。



半導体及び 電子デバイス事業



2009年3月期経営成績

半導体及び電子デバイス事業では、自社ブランドである「inrevium（インレビウム）」の開発ビジネスおよび重点戦略マーケットである産業機器分野に注力することに加え、国内販売子会社の営業開始や海外事業展開の推進により、顧客に密着した営業展開と新規顧客の開拓に努めてまいりました。

第2四半期までは携帯電話基地局向けカスタムICやPC向けメモリーICが比較的堅調に推移していたものの、第3四半期以降は急速な市場環境の悪化により、低調に推移することとなりました。

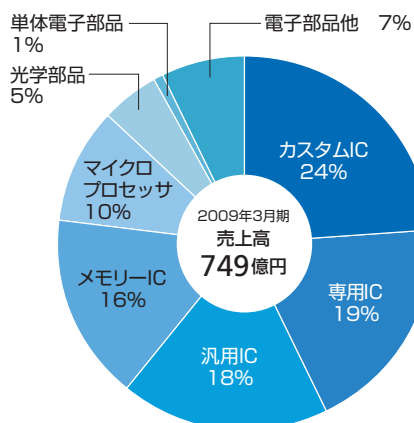
また、民生機器・産業機器をはじめとした各分野における生産調整等の影響を受け、売上高は749億8千万円、営業利益は7億3千6百万円となりました。

品目別売上

品目別の売上構成は、カスタムIC、専用IC、汎用IC（アナログIC）など、技術サポートを必要とする付加価値の高い商品の比率が高くなっており、お客様から高い信頼を得ています。

2009年3月期の特徴としては商権拡大が寄与し、マイクロプロセッサの売上高が前期比6%増となりましたが、そのほかは、下期からの事業環境の悪化を受け、前期比減少となりました。

品目別 売上構成



品目別 売上増減

品目	主な仕入先	対前年増減率
カスタム IC	ザイリンクス、富士通	▲ 10%
専用 IC	ピクセルワークス、IDT	▲ 12%
汎用 IC (アナログ IC)	リニアテクノロジー、TI	▲ 8%
メモリー IC	スパンション	▲ 30%
マイクロプロセッサ	フリースケール、富士通、TI	6%
光学部品・個別素子	アバゴ	▲ 19%
電子部品他	コーセル	▲ 13%

※社名は敬称を省略し、略称を使用させていただいております。

高付加価値の技術サポート

仕入先ごとに専属のフィールド・アプリケーション・エンジニア (FAE) を配置し、企画・製造の各段階を通してきめ細かい技術サポートを行っています。お客様に対して新製品の技術説明や提案、技術問い合わせへの対応、不具合問題の解決、品質情報の提供などを行うと同時に、仕入先に対しても商品評価や技術的な調査への協力をを行い、問題解決のできる技術商社として、双方から高い信頼を得ています。



主な用途とお客様

半導体及び電子デバイス事業のお客様は、電子機器メーカーを中心に1,000社以上にのぼり、パナソニックグループ、東芝グループ、富士通グループ、NECグループなどが上位のお客様となります。

用途別売上では、通信機器、産業機器、民生機器、コンピュータ&周辺機器など幅広い分野で実績を上げております。

2009年3月期の特徴としては、産業機器分野が、不況の影響を最も大きく受け、売上高構成比は29%から23%となりました。

用途と売上高構成比	主な最終製品	主なお客様
 30% 通信機器	携帯電話、ルーター、伝送装置、携帯電話基地局	NEC、パナソニック、日立、富士通 他
 23% 産業機器	半導体試験装置、医療機器、放送機器、ロボット、計測器	東芝、パナソニック、日立、三菱電機 他
 22% 民生機器	デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、薄型TV、AV機器	シャープ、ソニー、パナソニック、ヤマハ 他
 20% コンピュータ&周辺機器	プリンター、プロジェクター、POS、パソコン及び付属機器	エプソン、東芝、パナソニック、富士ゼロックス 他
 5% 車載機器	カーナビゲーション、カーオーディオ	アイシン、パナソニック、三菱電機 他

※社名は敬称を省略し、略称を使用させていただいております。(五十音順)

アジア地域に品質の高い半導体などの電子部品を提供

日系企業を主なお客様として、アジア地域に営業拠点を展開しています。2005年に東京エレクトロンデバイス香港を設立以来、多言語対応、良質な物流サービスなどに注力し、上海、大連、シンガポールと拠点を増やし、2008年1月にはシンガポールを現地法人化しました。

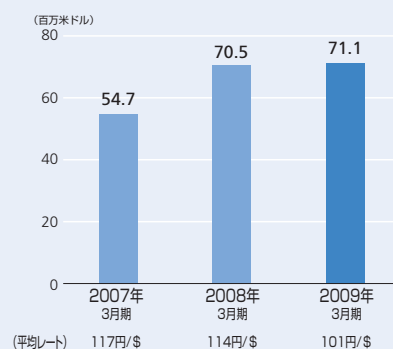
2009年3月期海外連結子会社の売上高は、世界的な景気悪化の影響を受けましたが、堅調に推移し、71百万ドル（日本円で約80億円）となりました。

今後もアジア地域のお客様開拓に努め、業容拡大を図ってまいります。



東京エレクトロンデバイス香港

海外ビジネス売上高



取扱商品


カスタムIC お客様の仕様に応じて作られる固有IC、ASICやPLDが代表製品

inrevium

主な商品	主な最終製品	主な仕入先（アルファベット順）
<ul style="list-style-type: none"> ● ASIC^{*1} ● PLD^{*2} (FPGA, CPLD) 	デジタル家電／携帯電話基地局／計測器／OA機器／放送機器／医療機器／半導体試験装置	富士通エレクトロニクス㈱、ザイリンクス社


専用IC 通信用や画像処理用など、特定用途向けに作られた専用のIC

主な商品	主な最終製品	主な仕入先（アルファベット順）
<ul style="list-style-type: none"> ● 通信・ネットワーク用 ● 画像処理用 ● インタフェース用 ● セキュリティ用 ● 周辺制御用 	デジタル家電／OA機器／ルーター／通信端末／プロジェクター／カーナビゲーション／監視カメラ	カビウム・ネットワークス社、フリースケール・セミコンダクタ社、富士通エレクトロニクス㈱、インターシル社、ピクセルワークス社


汎用IC 色々な用途に共通して使用されるIC、アナログICやロジックICなど

inrevium

主な商品	主な最終製品	主な仕入先（アルファベット順）
<ul style="list-style-type: none"> ● アナログ IC ● ロジック IC 	携帯電話／携帯電話基地局／FA機器／カーナビゲーション／OA機器／半導体試験装置	リニアテクノロジー社、オン・セミコンダクター社、テキサス・インスツルメンツ社


メモリーIC 記憶専用のIC、書き込みと読み出しが可能なRAM、読み出しのみのROMなど

主な商品	主な最終製品	主な仕入先（アルファベット順）
<ul style="list-style-type: none"> ● フラッシュメモリ^{*3} ● DRAM/SRAM ● FRAM 	デジタル家電／携帯電話／パソコン／計測器／OA機器／放送機器／医療機器／半導体試験装置／カーナビゲーション	富士通エレクトロニクス㈱、アイ・ディー・ティー社、ラムトロンインターナショナル社


マイクロプロセッサ コンピュータの中心となる頭脳として、演算・制御機能を持つIC

主な商品	主な最終製品	主な仕入先（アルファベット順）
<ul style="list-style-type: none"> ● マイクロプロセッサ ● マイクロコントローラ ● DSP 	デジタル家電／携帯電話／交換機／計測器／OA機器／放送機器／医療機器／半導体試験装置／カーナビゲーション	フリースケール・セミコンダクタ社、富士通エレクトロニクス㈱、テキサス・インスツルメンツ社


光学部品 電気を光に変換して使用する電子部品

主な商品	主な最終製品	主な仕入先（アルファベット順）
<ul style="list-style-type: none"> ● LED^{*4} ● フォトカプラ^{*5} ● 光ファイバ ● IrDA^{*6} 	交換機／携帯電話／FA機器／パソコン	アバゴ・テクノロジー社、住友電工デバイス・イノベーション㈱


単体電子部品 増幅や整流など、電気の基本機能を持つ部品

主な商品	主な最終製品	主な仕入先（アルファベット順）
<ul style="list-style-type: none"> ● ダイオード^{*7} ● トランジスタ 	携帯電話／パソコン／OA機器	オン・セミコンダクター社

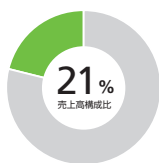

電子部品他 ボード製品や電源・コネクタなど一般電子部品

inrevium

主な商品	主な最終製品	主な仕入先（アルファベット順）
<ul style="list-style-type: none"> ● インタフェースボード ● 評価ボード ● パネル PC ● 電源 ● コネクタ ● 組み込みボード 	サーバー／FA機器／医療機器／計測器／半導体製造装置／ロボット	コーセル㈱、(株)PFU

※1 [ASIC] 高性能が望めるが、開発期間が長くなるカスタムIC。
 ※2 [PLD] プログラム可能な論理素子のカスタムIC。ASICより短期開発が可能。
 ※3 [フラッシュメモリ] データを電氣的に保存するメディア。電源が切れても保持が可能。
 ※4 [LED] 電流を流すと発光するダイオード。ランプや表示器に使用。

※5 [フォトカプラ] 電気信号を光に変換して伝達する素子。電氣的な絶縁が利点。
 ※6 [IrDA] 規格団体により制定された赤外線使用の通信機能。モバイル機器などで使用。
 ※7 [ダイオード] 電流を一方方向のみに流す整流作用を持つ電子部品。



コンピュータシステム 関連事業



2009年3月期経営成績

コンピュータシステム関連事業では、各企業における内部統制の整備を見据え、コンピュータシステムに関する需要増へ対応するため、コンピュータシステム関連事業の強化に努めてまいりました。しかしながら、企業業績の悪化と景気の先行き不安から、新規のIT投資等、設備投資を抑制する傾向が強まり、売上高は197億2千1百万円、営業利益は11億3百万円となりました。

品目別売上

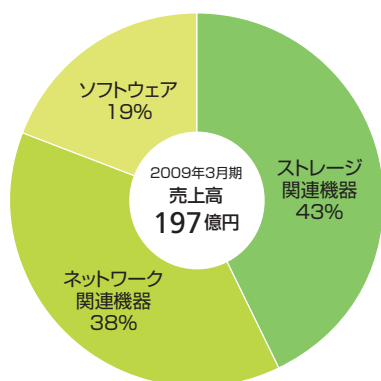
ストレージ関連機器の売上の中心は、米国のプロケード社です。ストレージエリアネットワークのスイッチに用いられる製品で、世界および日本でのシェアが80%を超える製品です。

ネットワーク関連機器の売上の中心は、米国のF5ネットワークス社です。インターネットなどのネットワークの負荷分散装置で、高い市場占有率を持っています。

ソフトウェアの売上の中心は、マイクロソフト社です。組み込み用のウィンドウズで、パソコン以外の機器に使用されています。

2009年3月期の特徴としては、ストレージ関連機器、ネットワーク関連機器は、企業のIT投資の抑制を受け、売上高は前期比減少となりました。ソフトウェアは、POS端末向けが減少したのと、会計基準を純額表示に変更した商品があり、前期比減少となりました。

品目別 売上構成



品目別 売上増減

品目	主な仕入先	対前年増減率
ストレージ関連機器	プロケード	▲ 21%
ネットワーク関連機器	F5ネットワークス	▲ 15%
ソフトウェア	マイクロソフト	▲ 39%

※社名は敬称を省略し、略称を使用させていただいております。

品質保証体制

製品品質、サポート品質、技術品質、お客様、パートナー様の満足と信頼性の向上を目指します。たとえば、入荷検査、出荷調整、品質管理、品質改善、検証作業、データ解析を専門組織が対応。安心してご使用いただけるよう保守サービス、製品保証を用意しています。



注力ビジネス

- F5ネットワークス社を中心としたシステム構築ビジネスの推進
- ストレージシステムの構築、内部統制向けソフトウェア製品の拡販
- 保守運用サポートビジネスの拡大

最新テクノロジーのマーケティング

コンピュータシステム関連事業では、最新のテクノロジーに関する情報をいち早く入手し、国内のお客様に最適な製品をご提供するように努めています。

2009年4月に新たに取り扱いを開始したAkorri（アコーリ）社の製品は、仮想化されたサーバー上でアプリケーションが正しく動作しているかどうかを一目でわかるように可視化するソフトウェアです。



取扱商品



ストレージ関連 SAN (ストレージ・エリア・ネットワーク) スイッチ、SAN 接続機器、ストレージセキュリティ機器など

主な商品

- SANファブリックスイッチ
- バックアップアプライアンス
- テープライブラリ
- ファイバーチャネルホストバスアダプタ
- クラスタ・ストレージ
- データ圧縮アプライアンス

主な仕入先 (アルファベット順)

アコーリ社、プロケードコミュニケーションズシステムズ社、データドメイン社、エミュレックス社、アイシロン・システムズ社、クアンタム社、ストアワイズ社、シマンテック社



ネットワーク関連 インターネット接続機器 (負荷分散、セキュリティ)、企業向けネットワークシステム構築機器など

主な商品

- アプリケーショントラフィックマネージャ
- LANスイッチ
- ファイアウォール
- ウェブアプリケーションファイアウォール
- ハードウェアセキュリティモジュール
- ファイル仮想化アプライアンス

主な仕入先 (アルファベット順)

エクストリーム・ネットワークス社、F5ネットワークス社、インバーバ社、インフォブロックス社、ジュニパーネットワークス社、タレス社



ソフトウェア 組込機器向けの OS やデータ管理を行うデータベースなど

主な商品

- OS
- 開発ツール
- インメモリ・データベース
- 組込データベース・エンジン
- ログ長期保存・分析ツール
- データウェアハウス用データベース・エンジン

主な仕入先 (アルファベット順)

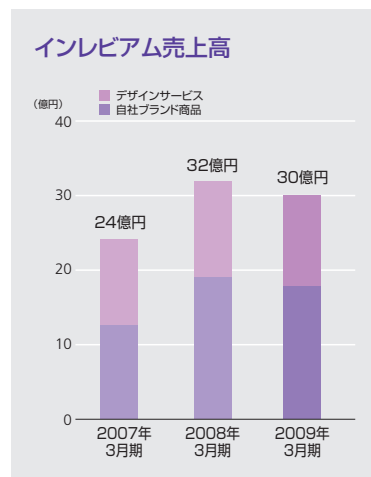
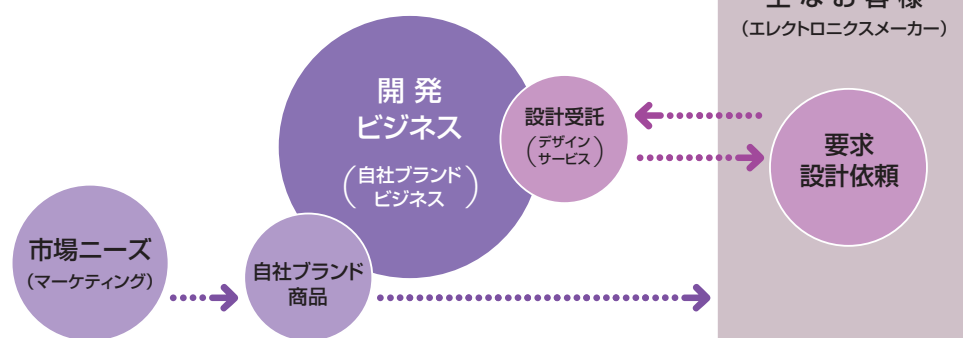
グリーンプラム社、インターバルゼロ社、マイクロソフト社、オラクル社、フェニックス・テクノロジーズ社、センセージ社

開発ビジネス

商社ではありますが、自社ブランド商品の設計・開発も手掛けており、メーカーとしての側面も持っています。

開発ビジネス（自社ブランドビジネス）は、お客様の要

求に基づきカスタムICやボードの設計を行う設計受託業務（デザインサービス）と市場ニーズに沿った商品の企画開発を行う自社ブランド商品で構成されています。



自社ブランド商品 (inrevium プロダクト)

長年培ってきた販売、設計・開発、マーケティング等の経験を活かして、お客様のニーズにフィットした自社ブランド商品を開発しています。画像処理やメモリ制御技術、通信インターフェース技術など当社保有の技術を活用した商品など、現在、60種類以上の商品・サービスを提供しています。



設計受託 (inrevium デザインサービス)

お客様の設計工数を削減すると同時に、経験豊富な専門家に任せることで、設計リスクの軽減や最新技術の活用、設備投資や維持費の低減などが容易に行え、しかも開発期間の短縮による商品の早期完成が可能になります。



設計開発センター (inrevium 開発センター)

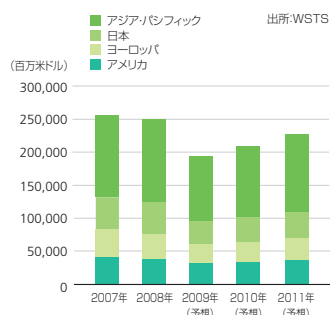
1985年に開設された設計開発センターでは、豊富な設計・開発の経験と、常に最新の技術動向を先取りした設備の導入により、自社ブランド商品の開発やお客様の要求に基づくデザインサービスを、スピーディかつ効率的に実現し、新商品の市場投入を短期間に安価で行うことを支援しています。現在、設計開発センターは日本の横浜と仙台、中国の上海と無錫の4箇所にあります。

また、この商品開発経験が、商社ビジネスの営業提案や技術サポートに活かされることにより、No.1 技術商社ならではのシナジー効果を創出しています。



マーケット情報

世界の半導体市場動向



ドルベースでの伸び率は、2008年は第4四半期に顕在化した世界金融危機の世界経済への影響を受け、前年比-2.8% (2,486億ドル) となりました。その後2009年は年前半も金融危機の影響が大きく残るため年率で-21.6%と2年連続のマイナス成長となりますが、2010年は+7.3%と成長軌道に戻り、2011年には、

+8.9%と成長を継続するものと予測されています。この結果、2008年から2011年までの年平均成長率は-2.9%となり、2011年の世界の半導体市場規模は2008年の市場規模を下回ると予測されています。2009年の市場規模は1,948億ドル (18兆2千1百億円)、前年比538億ドル減となるものと予測されています。

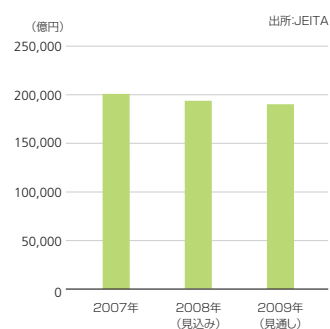
日本の半導体市場動向



円ベースでの日本の半導体市場伸び率は、2007年の堅調な成長(+6.4%)に対し、2008年は第4四半期の世界経済の影響のため、前年比-12.6%のマイナス成長となりました。2009年は前年比-35.5%とさらに大幅なマイナス成長となるものの、その後2010年は前年比+6.9%と回復基調に戻り、2011年には前年比+

8.1%と成長を継続すると予測されています。その結果、日本の半導体市場規模は、2008年は約5兆3百億円でしたが、2009年は約3兆2千4百億円、2010年は約3兆4千6百億円、2011年は約3兆7千4百億円となり、2008年から2011年までの年平均成長率は-9.4%となるものと予測されています。

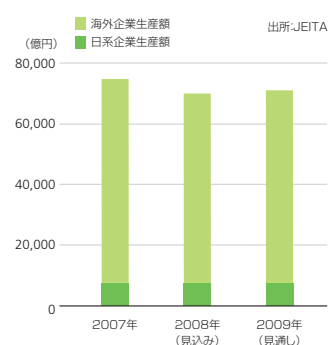
日本の電子工業生産



2009年の電子工業における国内生産額は、19兆387億円 (前年比-2%) と3年連続のマイナスが予測されています。薄型テレビやブルーレイ・ディスク・レコーダなどの製品は、2011年の地上デジタルテレビ放送への完全移行に向けてプラスで推移するものの、電子工業全体では景気悪化による購買意欲の低下の影響は避けられず、価格競争の激化によりさらなる海外生

産への移行が見込まれます。国内生産規模の大きい半導体については、輸出の不振も懸念されています。電子工業全体では、日系企業の国内生産比率は2008年は44%とすでに海外生産規模が国内生産規模を超えていますが、高度な信頼性や品質を要求される半導体、ディスプレイデバイスなどの分野では高い水準を維持すると予測されています。

サーバー・ストレージ世界および国内生産動向



2008年におけるサーバー・ストレージの世界生産額は、6兆9,990億円、世界生産額に占める日系企業の割合は約11%にあたる7,631億円、このうち国内生産は5,276億円、日系企業の国内生産比率は69%と見込まれています。世界の生産動向はここ数年、世界的にIT分野に対する投資は拡大する方向にあり、安定して成長していましたが、景況感の悪化によりマイナ

スになるものと見込まれています。市場はメインフレームからオープンサーバーへの需要分散などの影響を受けるものの、ネットワーク化のさらなる進展や情報セキュリティへの対応などがあり、今後は緩やかな成長が続くと予測されています。国内生産動向はオープンサーバーを中心に、競争力強化のために海外生産への移行もあり、生産規模は縮小傾向と予測されています。

業績レビューと次期の見通し

当期（2009年3月期）の業績報告

当連結会計年度におけるわが国経済は、北米に端を発した前連結会計年度からの金融不安が拡大し、期首において足踏み状態であった景気が、秋頃より急減速する形で推移いたしました。金融危機の深刻化が、企業業績・雇用・消費等の実体経済に影響を及ぼし、世界的な経済危機に対する懸念が深度を増しております。

当社グループが参画しておりますエレクトロニクス業界におきましては、上半期において、北京オリンピック開催によるデジタル家電の需要拡大が期待されておりましたが、景況感の悪化から総じて低調に推移いたしました。下半期に入り、特に11月以降においては、未曾有の大不況の影響

を受け、デジタル家電をはじめ、パソコン、携帯電話、産業機器等ほぼ全分野で需要が急速に冷え込み、非常に厳しい状況で推移いたしました。

このような状況のもと、当連結会計年度の売上高は947億1百万円（前期比15.5%減）、営業利益は18億4千万円（前期比50.0%減）、経常利益は20億4千1百万円（前期比47.0%減）となりました。また、当社グループの取引先に対し、特別損失として貸倒引当金繰入額を計上したこと等により、当期純利益は6億1千7百万円（前期比71.8%減）となりました。

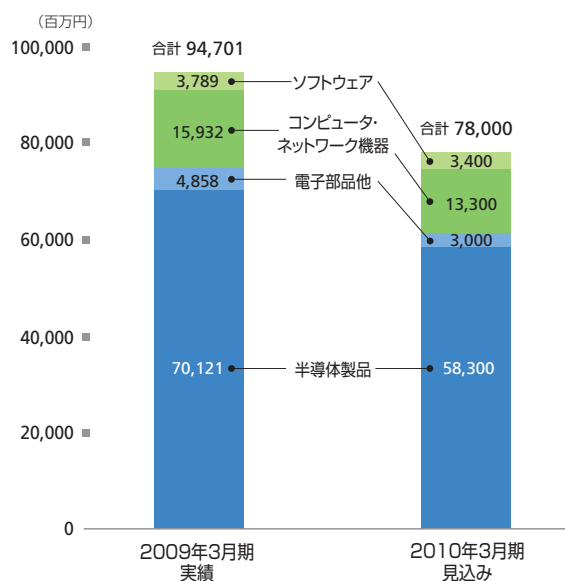
次期（2010年3月期）の見通し

今後の見通しにつきましては、世界的な経済危機に対し、各国において対策が講じられておりますが、依然として景気がさらに下振れる恐れが払拭できない状況が続いております。当社グループが参画しておりますエレクトロニクス業界につきましては、これまでの在庫調整が進むことで、一時的には半導体需要の回復が期待されておりますが、エレクトロニクス製品全般の需要自体が弱いことから、中長期的な市況回復の見通しについてはなお不透明感が強く、また、為替の変動等による輸出入への影響も懸念材料とされ

ております。

こうした状況のもと、当社グループでは、組織改編による事業構築の見直しや、外部環境によるマイナス影響を最小限にとどめるようなビジネス体制の強化に取り組み、業績の回復に努めてまいります。2010年3月期の連結業績見通しにつきましては、売上高780億円（前期比17.6%減）、営業利益14億5千万円（前期比21.2%減）、経常利益13億円（前期比36.3%減）、当期純利益6億2千万円（前期比0.4%増）を見込んでおります。

2010年3月期 品目別 連結売上高予想



2010年3月期 連結業績予想

(単位：百万円)	上期予想	下期予想	通期予想
売上高	37,000	41,000	78,000
営業利益	360	1,090	1,450
経常利益	300	1,000	1,300
当期純利益	140	480	620

財務諸表

連結財務諸表

連結貸借対照表

資産の部	前期	当期
	(2008年3月31日現在)	(2009年3月31日現在)
	千円	千円
流動資産	47,005,467	35,854,988
現金及び預金	1,367,624	1,245,602
受取手形及び売掛金	25,633,561	15,479,382
たな卸資産	17,649,887	-
商品及び製品	-	15,812,839
仕掛品	-	66,631
繰延税金資産	624,533	497,069
未収消費税等	811,642	1,144,199
その他	929,676	1,610,822
貸倒引当金	△ 11,458	△ 1,559
固定資産	4,453,012	4,825,237
有形固定資産	1,012,699	1,334,856
建物及び構築物（純額）	550,745	865,581
工具、器具及び備品（純額）	461,954	446,955
リース資産（純額）	-	22,320
無形固定資産	785,538	643,933
投資その他の資産	2,654,774	2,846,446
投資有価証券	119,797	49,115
繰延税金資産	1,401,918	1,622,276
その他	1,141,758	1,686,565
貸倒引当金	△ 8,699	△ 511,509
資産合計	51,458,480	40,680,225

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

資産

総資産は406億8千万円となり、前連結会計年度末に比べ107億7千8百万円の減少となりました。これは主に、受取手形及び売掛金、商品及び製品が減少したことによりです。

負債

負債総額は192億6千6百万円となり、前連結会計年度末に比べ105億8千6百万円の減少となりました。これは主に、買掛金、短期借入金が減少したことによりです。

負債の部	前期	当期
	(2008年3月31日現在)	(2009年3月31日現在)
	千円	千円
流動負債	25,584,200	14,482,369
買掛金	13,897,701	6,706,615
短期借入金	6,069,679	3,806,681
未払金	1,582,518	856,930
未払法人税等	1,043,627	177,903
前受金	-	2,137,465
賞与引当金	663,307	488,256
役員賞与引当金	44,550	-
その他	2,282,815	308,517
固定負債	4,269,405	4,784,484
退職給付引当金	3,859,577	4,304,637
役員退職慰労引当金	129,928	115,100
その他	279,900	364,747
負債合計	29,853,605	19,266,854
純資産の部		
株主資本	21,579,799	21,492,916
資本金	2,495,750	2,495,750
資本剰余金	5,645,240	5,645,240
利益剰余金	13,438,808	13,351,925
評価・換算差額等	25,074	△ 79,545
その他有価証券評価差額金	△ 5,420	△ 6,002
繰延ヘッジ損益	64,622	△ 28,442
為替換算調整勘定	△ 34,127	△ 45,100
純資産合計	21,604,874	21,413,370
負債純資産合計	51,458,480	40,680,225

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

純資産

純資産総額は214億1千3百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億9千1百万円の減少となりました。

連結財務諸表

連結損益計算書

科 目	前 期	当 期
	2007年4月 1日から 2008年3月31日まで	2008年4月 1日から 2009年3月31日まで
	千円	千円
売上高	112,104,644	94,701,532
売上原価	95,147,030	79,992,053
売上総利益	16,957,614	14,709,479
販売費及び一般管理費	13,278,745	12,869,389
給料及び手当	4,560,679	4,600,607
賞与引当金繰入額	651,225	471,960
役員賞与引当金繰入額	44,550	-
退職給付引当金繰入額	573,239	753,610
その他	7,449,050	7,043,211
営業利益	3,678,869	1,840,090
営業外収益	428,747	413,161
受取利息	2,189	896
受取配当金	-	249
為替差益	394,956	348,361
セミナー開催収入	6,173	2,893
受取保険金	-	25,260
保険配当金	18,226	23,231
その他	7,201	12,268
営業外費用	258,348	212,021
支払利息	80,833	72,862
売上債権売却損	167,732	132,678
その他	9,782	6,479
経常利益	3,849,269	2,041,230
特別利益	133	-
固定資産売却益	133	-
特別損失	21,437	746,487
固定資産売却損	-	183
固定資産除却損	7,507	20,525
貸倒引当金繰入額	-	497,860
ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額	-	469
ゴルフ会員権評価損	-	14,879
事務所原状回復費用	13,930	-
本社移転費用	-	212,569
税金等調整前当期純利益	3,827,964	1,294,743
法人税、住民税及び事業税	1,723,550	705,777
法人税等調整額	△ 88,669	△ 28,474
当期純利益	2,193,084	617,440

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

連結キャッシュ・フロー計算書

科 目	前 期	当 期
	2007年4月 1日から 2008年3月31日まで	2008年4月 1日から 2009年3月31日まで
	千円	千円
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	3,827,964	1,294,743
減価償却費	364,982	473,286
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	9,666	492,864
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 158,364	△ 174,868
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	18,550	△ 44,550
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	244,454	445,060
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	18,021	△ 14,828
受取利息及び受取配当金	△ 2,189	△ 1,146
支払利息	80,833	72,862
為替差損益 (△は益)	1,491	△ 57
有形固定資産売却損益 (△は益)	△ 133	183
有形固定資産除却損	7,507	18,828
無形固定資産除却損	-	1,696
ゴルフ会員権評価損	-	14,879
売上債権の増減額 (△は増加)	△ 2,465,392	10,140,781
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 859,855	1,870,104
仕入債務の増減額 (△は減少)	1,202,636	△ 7,181,805
未収消費税等の増減額 (△は増加)	△ 281,497	△ 332,489
その他	134,729	△ 1,878,928
小計	2,143,405	5,196,618
利息及び配当金の受取額	2,189	1,146
利息の支払額	△ 83,028	△ 72,895
法人税等の支払額	△ 1,680,815	△ 1,557,953
営業活動によるキャッシュ・フロー	381,751	3,566,916
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△ 373,581	△ 618,441
有形固定資産の売却による収入	399	1,075
無形固定資産の取得による支出	△ 598,530	△ 112,622
投資有価証券の取得による支出	△ 69,702	-
その他	△ 214,535	△ 71,307
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,255,951	△ 801,295
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	4,801,944	△ 2,253,780
長期借入金の返済による支出	△ 3,000,000	-
配当金の支払額	△ 667,800	△ 699,600
リース債務の返済による支出	-	△ 1,490
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,134,144	△ 2,954,870
現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 34,987	124
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	224,956	△ 189,125
現金及び現金同等物の期首残高	1,142,667	1,367,624
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	67,103
現金及び現金同等物の期末残高	1,367,624	1,245,602

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

連結株主資本等変動計算書

	株主資本				評価・換算差額等				純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計	その他 有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等合計	
	千円								
2008年3月31日残高	2,495,750	5,645,240	13,438,808	21,579,799	△ 5,420	64,622	△ 34,127	25,074	21,604,874
連結会計年度中の変動額									
連結範囲の変動			△ 4,724	△ 4,724					△ 4,724
剰余金の配当			△ 699,600	△ 699,600					△ 699,600
当期純利益			617,440	617,440					617,440
株主資本以外の項目の 連結会計年度中の変動額(純額)					△ 582	△ 93,064	△ 10,973	△ 104,620	△ 104,620
連結会計年度中の変動額合計	-	-	△ 86,883	△ 86,883	△ 582	△ 93,064	△ 10,973	△ 104,620	△ 191,503
2009年3月31日残高	2,495,750	5,645,240	13,351,925	21,492,916	△ 6,002	△ 28,442	△ 45,100	△ 79,545	21,413,370

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

個別財務諸表

個別貸借対照表

資産の部	当 期	負債の部	当 期	
	(2009年3月31日現在)		(2009年3月31日現在)	
	千円		千円	
流動資産	35,253,948	流動負債	13,954,381	
現金及び預金	1,185,547	買掛金	6,493,653	
受取手形	369,627	短期借入金	3,100,000	
売掛金	14,080,558	リース債務	5,534	
商品及び製品	15,132,031	未払金	1,264,579	
仕掛品	66,631	未払費用	167,665	
前渡金	290	未払法人税等	174,724	
前払費用	754,080	前受金	2,137,465	
繰延税金資産	491,610	預り金	49,793	
未収入金	1,310,731	前受収益	-	
未収消費税等	1,141,953	賞与引当金	479,382	
立替金	720,898	役員賞与引当金	-	
その他	1,634	その他	81,582	
貸倒引当金	△ 1,648	固定負債	4,784,484	
固定資産	4,915,189	リース債務	18,347	
有形固定資産	1,321,700	退職給付引当金	4,304,637	
建物(純額)	852,272	役員退職慰労引当金	115,100	
構築物(純額)	9,878	その他	346,400	
工具、器具及び備品(純額)	437,229	負債合計	18,738,866	
リース資産(純額)	22,320	純資産の部		
無形固定資産	631,736	株主資本	21,464,716	
投資その他の資産	2,961,753	資本金	2,495,750	
投資有価証券	49,115	資本剰余金	5,645,240	
繰延税金資産	1,629,401	利益剰余金	13,323,725	
その他	1,283,236	評価・換算差額等	△ 34,444	
資産合計	40,169,137	その他有価証券評価差額金	△ 6,002	
		繰延ヘッジ損益	△ 28,442	
		純資産合計	21,430,271	
		負債純資産合計	40,169,137	

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

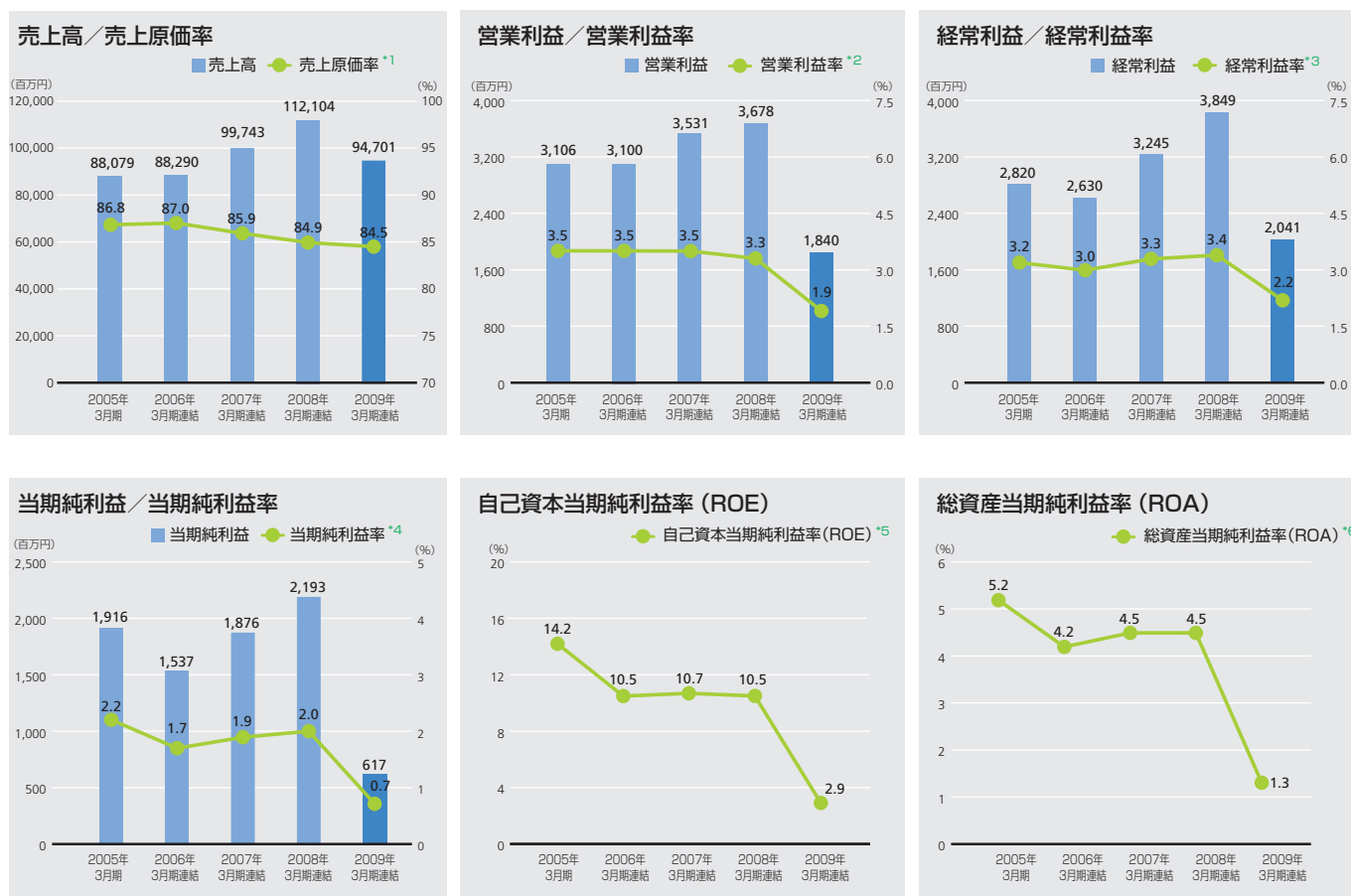
個別損益計算書

科 目	当 期
	2008年4月1日から 2009年3月31日まで
	千円
売上高	88,009,490
売上原価	73,921,218
売上総利益	14,088,272
販売費及び一般管理費	12,218,979
給料及び手当	4,335,243
賞与引当金繰入額	432,710
退職給付引当金繰入額	726,254
減価償却費	442,527
研究開発費	253,758
その他	6,028,484
営業利益	1,869,292
営業外収益	534,369
受取利息	835
受取配当金	249
為替差益	287,234
その他	246,047
営業外費用	199,196
支払利息	46,928
売上債権売却損	132,668
その他	19,599
経常利益	2,204,465
特別利益	-
特別損失	743,806
固定資産売却損	183
固定資産除却損	20,525
貸倒引当金繰入額	501,479
本社移転費用	206,269
その他	15,348
税引前当期純利益	1,460,659
法人税、住民税及び事業税	677,278
法人税等調整額	13,835
当期純利益	769,545

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

財務データ

収益性



	2005年3月期	2006年3月期 連結	2007年3月期 連結	2008年3月期 連結	2009年3月期 連結
売上高 (百万円)	88,079	88,290	99,743	112,104	94,701
売上原価率 (%) *1	86.8	87.0	85.9	84.9	84.5
営業利益 (百万円)	3,106	3,100	3,531	3,678	1,840
営業利益率 (%) *2	3.5	3.5	3.5	3.3	1.9
経常利益 (百万円)	2,820	2,630	3,245	3,849	2,041
経常利益率 (%) *3	3.2	3.0	3.3	3.4	2.2
当期純利益 (百万円)	1,916	1,537	1,876	2,193	617
当期純利益率 (%) *4	2.2	1.7	1.9	2.0	0.7
自己資本当期純利益率 (ROE)(%) *5	14.2	10.5	10.7	10.5	2.9
総資産当期純利益率 (ROA)(%) *6	5.2	4.2	4.5	4.5	1.3

*1. 売上原価率 = 売上原価 ÷ 売上高

*2. 営業利益率 = 営業利益 ÷ 売上高

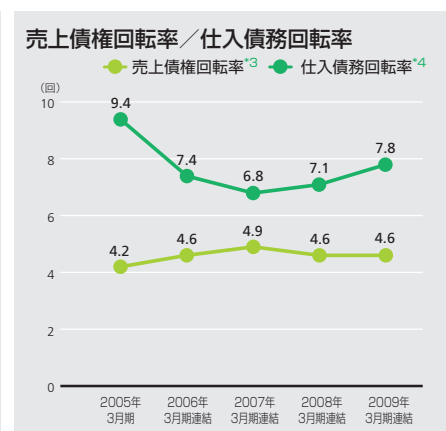
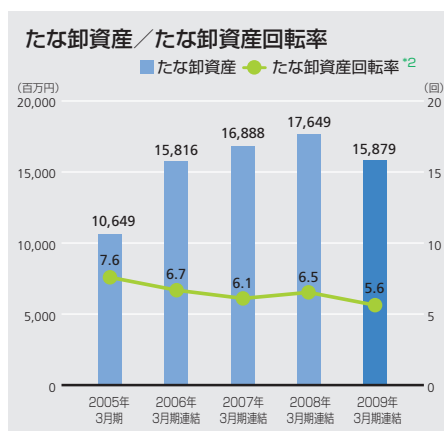
*3. 経常利益率 = 経常利益 ÷ 売上高

*4. 当期純利益率 = 当期純利益 ÷ 売上高

*5. 自己資本当期純利益率 (ROE) = 当期純利益 ÷ 期首・期末平均株主資本

*6. 総資産当期純利益率 (ROA) = 当期純利益 ÷ 期首・期末平均総資産

効率性・安全性



	2005年3月期	2006年3月期 連結	2007年3月期 連結	2008年3月期 連結	2009年3月期 連結
総資産 (百万円)	35,988	37,088	46,729	51,458	40,680
総資産回転率 (回) *1	2.4	2.5	2.4	2.3	2.1
たな卸資産 (百万円)	10,649	15,816	16,888	17,649	15,879
たな卸資産回転率 (回) *2	7.6	6.7	6.1	6.5	5.6
売上債権回転率 (回) *3	4.2	4.6	4.9	4.6	4.6
仕入債務回転率 (回) *4	9.4	7.4	6.8	7.1	7.8
流動資産 (百万円)	33,510	34,749	43,387	47,005	35,854
流動比率 (%) *5	211.8	217.6	191.0	183.7	247.6
負債総額 (百万円)	21,772	21,928	26,673	29,853	19,266
負債比率 (%) *6	153.2	144.6	133.0	138.3	89.6
純資産 (百万円)	14,216	15,160	20,056	21,604	21,413
自己資本比率 (%) *7	39.5	40.9	42.9	41.9	52.6

*1. 総資産回転率=売上高÷期首・期末平均総資産

*2. たな卸資産回転率=売上高÷期首・期末平均たな卸資産

*3. 売上債権回転率=売上高÷期首・期末平均(受取手形+売掛金)

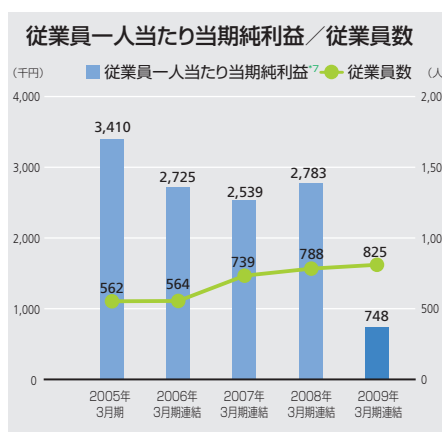
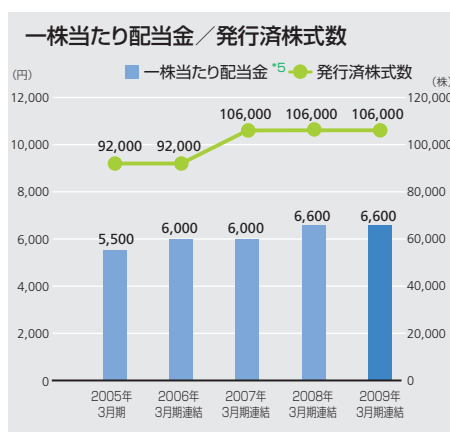
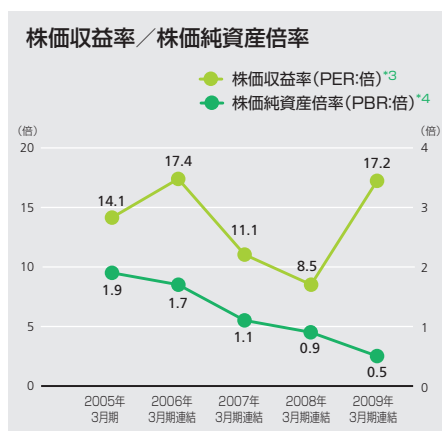
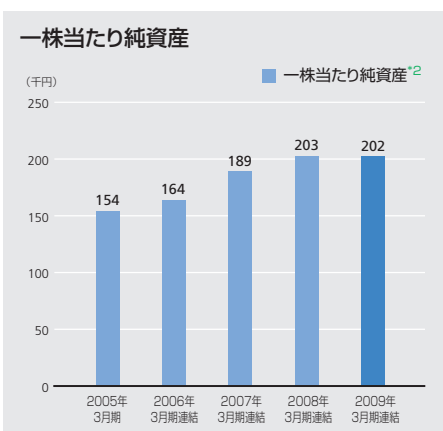
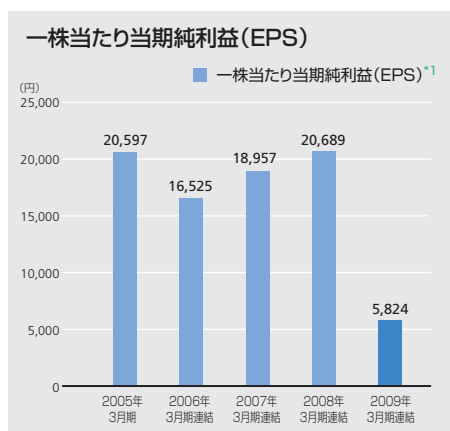
*4. 仕入債務回転率=売上原価÷期首・期末平均買掛金

*5. 流動比率=流動資産÷流動負債

*6. 負債比率=負債÷株主資本

*7. 自己資本比率=株主資本÷総資産

その他の指標



	2005年3月期	2006年3月期 連結	2007年3月期 連結	2008年3月期 連結	2009年3月期 連結
一株当たり当期純利益 (EPS: 円) *1	20,597	16,525	18,957	20,689	5,824
一株当たり純資産 (千円) *2	154	164	189	203	202
株価収益率 (PER: 倍) *3	14.1	17.4	11.1	8.5	17.2
株価純資産倍率 (PBR: 倍) *4	1.9	1.7	1.1	0.9	0.5
一株当たり配当金 (円) *5	5,500	6,000	6,000	6,600	6,600
発行済株式数 (株)	92,000	92,000	106,000	106,000	106,000
配当金 (千円)	506,000	552,000	594,000	699,600	699,600
配当性向 (%) *6	26.7	36.3	31.7	31.9	113.3
従業員一人当たり当期純利益 (千円) *7	3,410	2,725	2,539	2,783	748
従業員数 (人)	562	564	739	788	825

*1. 一株当たり当期純利益 (EPS) = 当期純利益 ÷ 期中平均発行済株式数

*2. 一株当たり純資産 = 期末純資産 ÷ 期末発行済株式数

*3. 株価収益率 (PER) = 期末株価 ÷ 一株当たり当期純利益

*4. 株価純資産倍率 (PBR) = 期末株価 ÷ 一株当たり純資産

*5. 一株当たり配当金 = 支払済中間配当及び期末配当金 ÷ 発行済株式数

*6. 配当性向 = 支払済中間配当及び期末配当金 ÷ 当期純利益

*7. 従業員一人当たり当期純利益 = 当期純利益 ÷ 期末従業員数

会社概要・株式情報

会社概要

会社の概要 (2009年3月31日現在)

商号	東京エレクトロン デバイス株式会社 TOKYO ELECTRON DEVICE LIMITED
設立	1986年3月3日
資本金	2,495,750,000円
従業員数	825名 (連結)



(本社)
神奈川県横浜市神奈川区金港町1-4 横浜イーストスクエア

役員等 (2009年6月17日現在)

取締役

代表取締役社長	砂川俊昭
取締役	久我宣之
取締役	木村勉
取締役	天野勝之
取締役	徳重敦之
取締役	東哲郎
取締役	原護
取締役	岩田義文

監査役

常勤監査役	浅野升徳
監査役	田中健生
監査役	林田謙一郎
監査役	川勝正昭

- (注) 1. 岩田義文氏は、社外取締役であります。
2. 林田謙一郎氏及び川勝正昭氏は社外監査役であります。

執行役員

砂川俊昭
久我宣之
木村勉
天野勝之
徳重敦之
穴倉弘明
大崎正之
八幡浩司
武井弘治
黒田修治
山田信二
林英樹

拠点網 (2009年3月31日現在)

本社	CN新宿オフィス CN大阪オフィス
本社営業部 北関東支社 大阪支社	エンジニアリングセンター
仙台営業所 水戸営業所 松本営業所 浜松営業所 京都営業所 福岡営業所 宇都宮サテライト 厚木サテライト 松山出張所	長岡営業所 立川営業所 三島営業所 名古屋営業所 岡山営業所
上海華桑電子有限公司 (通称：東京エレクトロンデバイス上海) 香港華桑電子有限公司 (通称：東京エレクトロンデバイス香港) 無錫華桑電子科技有限公司 (通称：東京エレクトロンデバイス無錫) Tokyo Electron Device Singapore Pte. Ltd. (通称：東京エレクトロンデバイスシンガポール) パネトロン株式会社	

株式情報 (2009年3月31日現在)

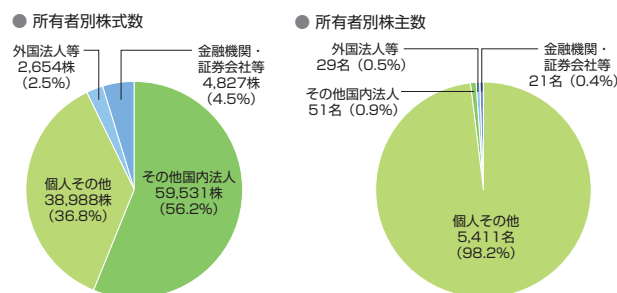
株式の状況

● 発行可能株式総数	256,000株
● 発行済株式の総数	106,000株
● 株主数	5,512名

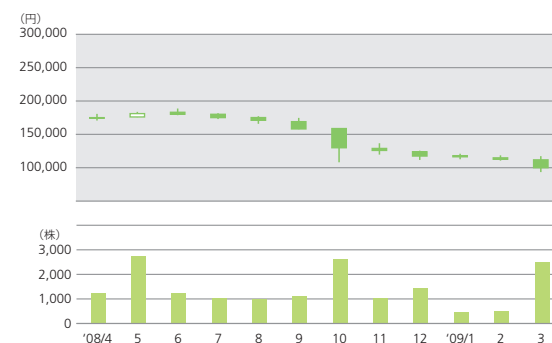
大株主

株主名	持株数	出資比率
	株	%
東京エレクトロン株式会社	58,753	55.42
立花証券株式会社	3,709	3.49
東京エレクトロンデバイス社員持株会	3,679	3.47
ノーザン・トラスト・カンパニー・エイブイ・エフ・シー・リ・ノーザン・トラスト・ガンジー・ノン・トリーティー・クライアーツ	889	0.83
パークレイズ・バンク・ピーエルシー・パークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ	829	0.78
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	477	0.45

株式分布状況



株価と出来高



個人投資家様向けIR活動

当社は、新聞社や証券会社等が主催するIRフェアや個人投資家説明会に参加しています。



日経IRフェア2008
(2008年8月23日・東京ビッグサイト)

ホームページ

当社のホームページでは、会社案内、製品・技術情報、IR情報など、豊富なインフォメーションを発信しています。(http://www.teldevice.co.jp/)



トップページ



IR情報ページ

お問い合わせ先



® 東京エレクトロン デバイス株式会社

広報・IR室 E-mail: ir-info@teldevice.co.jp

本社：〒221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町1番地4 横浜イーストスクエア
Tel.045-443-4000 (代表) Fax.045-443-4050

再生紙を使用しております。



環境に配慮した「大豆インキ」を使用しています。